

论坛日程

Forum Agenda

9月24日，星期三 Wednesday, 24 September			
上午	10:10-11:50	N4B50论坛区	10:10-11:50N4E50论坛区
	宽禁带半导体—氮化镓 WBG_GaN		电力电子技术 Power Electronics
	主持人：温旭辉，中国科学院电工研究所，主任研究员 Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences		主持人：陈子颖
	11:50-13:20	午餐 Lunch break	
下午	13:20-16:00	N4B50论坛区	13:20-16:20N4E50论坛区
	功率器件（一） Power Devices I		材料与封装 Materials & Packaging
	主持人：陈立烽，英飞凌科技，高级技术总监 工业与基础设施业务大中华区技术负责人 Infineon Technologies AG		主持人：王顺利，内蒙古工业大学，教授 Inner Mongolia University of Technology
9月25日，星期四 Thursday, 25 September			
上午	10:00-12:00	N4B50论坛区	10:00-12:00N4E50论坛区
	电气化交通 E-Mobility		功率器件（二） Power Devices II
	主持人：康劲松，同济大学，教授 Tongji University		主持人：韩金刚，上海海事大学，副教授 Shanghai Maritime University
	12:00-13:20	午餐 Lunch break	
下午	13:20-16:00	N4B50论坛区	13:20-16:00N4E50论坛区
	宽禁带半导体—碳化硅 WBG_SiC		人工智能与数据中心 AI & Data Center
	主持人：陈子颖		主持人：孙耀杰，复旦大学，教授 Fudan University
9月26日，星期五 Friday, 26 September			
上午	10:00-15:00	N4B50论坛区	10:00-15:00N4E50论坛区
	未来趋势应用峰会 Emerging Applications Summit		功率半导体新锐峰会 Power Semiconductor Rising Star Summit
	10:00-12:00 低空飞行器动力技术前沿论坛 eVTOL Forum		主持人：张波，电子科技大学，教授 University of Electronic Science and Technology of China
下午	13:00-15:00 固态开关驱动下一代高频高可靠拓扑创新论坛 Solid-State Circuit Breaker Forum		

主题论坛赞助商 Theme Forum Sponsor



演讲单位 Speakers



*排名不分先后 Not in specific order

论坛日程

Forum Agenda

9月24日， 星期三 Wednesday, 24 September

9月24日， 星期三 Wednesday, 24 September

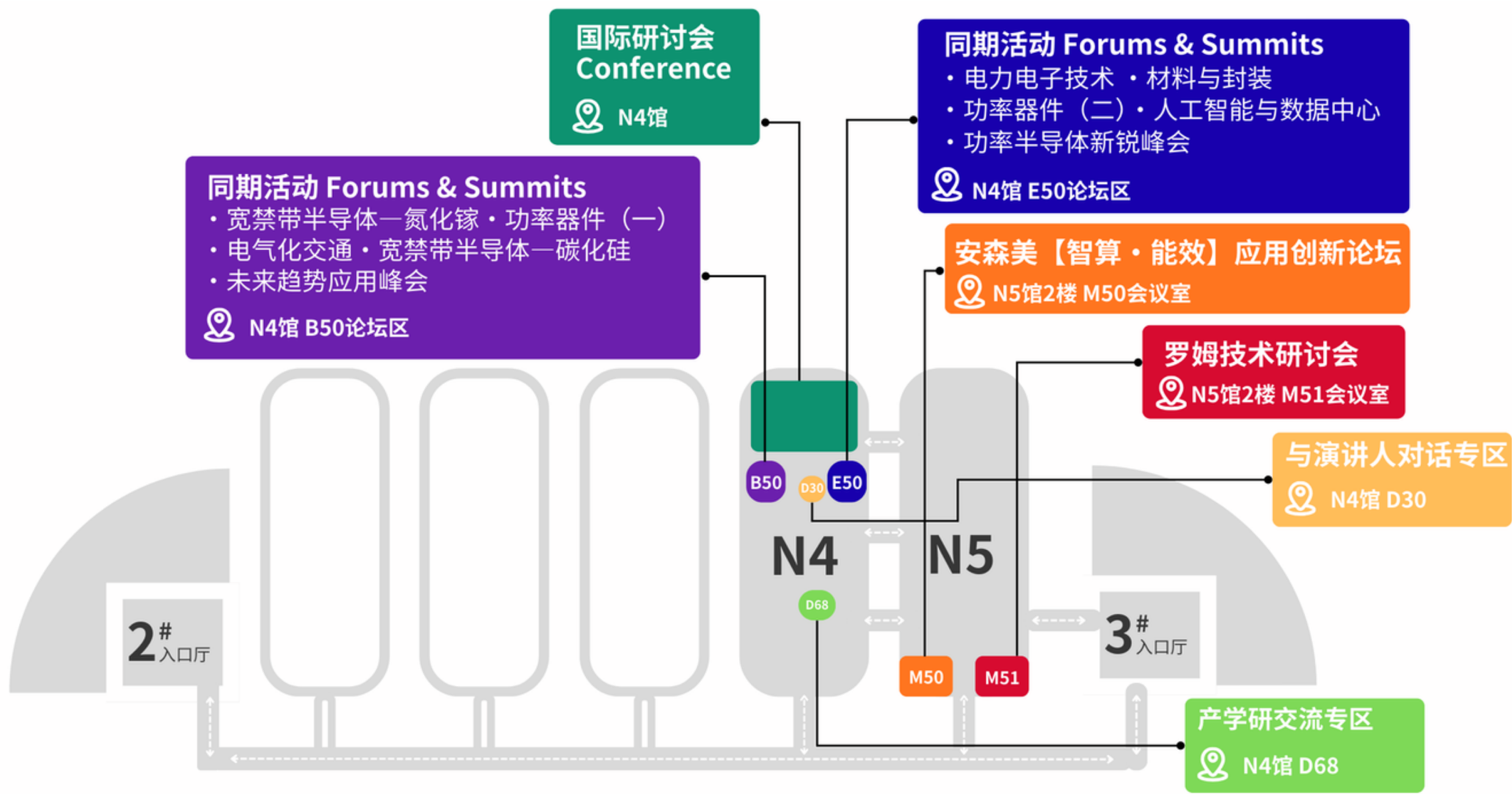
N4B50论坛区	N4E50论坛区
宽禁带半导体—氮化镓 WBG_GaN 主持人：温旭辉，中国科学院电工研究所，主任研究员 Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences	电力电子技术 Power Electronics 主持人：陈子颖
10:10-10:30 英飞凌CoolGaN™ G5 重新定义功率密度 柯春山，英飞凌科技，首席工程师 Infineon Technologies AG	10:10-10:30 以电力电子高可靠应用为导向的SiC MOSFET动态可靠性创新测试解决方案 毛赛君，忱芯科技（上海）有限公司，总经理 UniSiC Technology (Shanghai) Co., Ltd.
10:30-10:50 罗姆GaN Device助力高效电源设计 李素娟，罗姆半导体（上海）有限公司，经理 ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	10:30-10:50 Technologies for WBG power semiconductor characterization – Static to dynamic characterization Tom Neville, Worldwide Business Development Manager, Keysight Technology Inc. 是德科技（中国）有限公司
10:50-11:10 Next Generation GaN: Displacing Silicon in Low-Voltage Power Conversion Alex Lidow, CEO, Efficient Power Conversion (EPC) 宜普电源转换公司	10:50-11:10 昆芯科技 2200V 系列碳化硅功率器件专场发布 王颢，昆芯（上海）科技有限公司，总经理 SHANGHAI KUNSEMI TECHNOLOGY CO., LTD.
11:10-11:30 氮化镓如何高效赋能48 V电机驱动应用 成皓，安世半导体， GaN产品线资深市场拓展经理 Nexperia	11:10-11:30 汽车主驱逆变器烧结工艺整体解决方案 凌晓渊，奥芯明半导体设备技术（上海）有限公司， 汽车功率半导体业务负责人 AMSPT
11:30-11:50 Powering the Future: GaN Innovation for Next-Gen Applications Min Chen, Vice President of GaN IC Products, Innoscience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd. 英诺赛科（苏州）科技股份有限公司	11:30-11:50 SiC功率半导体测试及驱动解决方案 程加昌，杭州飞仕得科技有限公司，设备事业部副总经理 Hangzhou Firstack Technology Co., Ltd.
11:50-13:20 午餐 Lunch break	
N4B50论坛区	N4E50论坛区
功率器件 （一） Power Devices I 主持人：陈立烽，英飞凌科技，高级技术总监 工业与基础设施业务大中华区技术负责人 Infineon Technologies AG	材料与封装 Materials & Packaging 主持人：王顺利，内蒙古工业大学，教授 Inner Mongolia University of Technology
13:20-13:40 可靠性革命：Easy C 系列创新设计破解高温、功率、寿命三重挑战 周明，英飞凌科技，工业与基础 设施业务大中华区主任工程师 Infineon Technologies AG	13:20-13:40 下一代电力电子先进封装材料与系统集成 殷雪冬，锢泰公司，区域技术经理 Indium Corporation
13:40-14:00 Bosch SiC portfolio and advantages to enable CN NEV development and fulfill customers' demand Anne Bedacht, Director Product Management Power SC, Robert Bosch GmbH 罗伯特·博世有限公司	13:40-14:00 低温烧结纳米银、铜产品及其面向汽车应用的封装互连技术 梅云辉，广州汉源微电子封装材料有限公司，技术专家 Solderwell Microelectronic Packaging Materials Co.,Ltd.
14:00-14:20 面向铁路和电力系统应用的高压IGBT和SiC模块 胡博，三菱电机机电（上海）有限公司，应用技术副经理 Mitsubishi Electric & Electronics (SHANGHAI) CO., LTD.	14:00-14:20 Macdermid Alpha Bondpad®功率芯片顶部烧结方案 赵宇，麦德美爱法，高级业务发展经理 MacDermid Alpha
14:20-14:40 100千瓦：用于兆瓦级电动汽车充电的下一代模块 赵新壁，安森美，电源方案事业部市场拓展经理 onsemi	14:20-14:40 持续创新与本土化驱动碳化硅模块在中国的发展 董侃，上海贺利氏工业技术材料有限公司，功率市场总监 Heraeus Materials Technology Shanghai Ltd.
14:40-15:00 轨道交通中适用于3.3kV碳化硅MOSFET的可靠驱动解决方案 安芳，Power Integrations，高级系统工程师	14:40-15:00 功率器件全烧结方案与挑战 贾强，北京清连科技有限公司，董事长 Beijing QLsemi Technology Co.,Ltd.
15:00-15:20 拓展适用于1500V系统的2kV碳化硅产品系列 朱凤杰，赛米控丹佛斯电子（珠海）有限公司，现场应用中国区经理 Semikron Danfoss Electronics (Zhuhai) Co., Ltd.	15:00-15:20 聚焦 Al₂O₃/AlN/ZTA/Si₃N₄基板技术特性、应用与创新范围 CeramTec GmbH，中国区销售总监
15:20-15:40 安世车规CCPAK1212 MOSFET ，提供更高功率密度解决方案 罗金，安世半导体，MOS产品线中国区市场经理 Nexperia	15:20-15:40 适用于功率器件的甲酸回流炉锡膏助焊剂技术开发 韦伟，株式会社弘辉，营业部长 KOKI COMPANY LIMITED
15:40-16:00 东芝碳化硅技术和产品 屈兴国，东芝电子元件（上海）有限公司，技术部 副总监 Toshiba Devices & Storage (Shanghai) Co., Ltd.	15:40-16:00 有压纳米银烧结工艺量产应用实践与检讨 田天成，苏州宝士曼半导体设备有限公司，总经理 Suzhou Boschman Semiconductor Equipment Co., Ltd.
	16:00-16:20 纳米铜复合焊料：助力功率模块实现低温高可靠连接 杨帆，深圳芯源新材料有限公司，研发总监 Shenzhen Xinyuan New Materials Co.,Ltd.

论坛日程

Forum Agenda

9月26日， 星期五		Friday, 26 September		
上午	N4B50论坛区	N4E50论坛区		
	未来趋势应用峰会 Emerging Applications Summit 低空飞行器动力技术前沿论坛 eVTOL Forum	功率半导体新锐峰会 Power Semiconductor Rising Star Summit 主持人：张波， 电子科技大学， 教授 University of Electronic Science and Technology of China		
	10:00-10:30 汽车供应链企业切入低空的机遇与挑战 皇甫乐晓， 敏实集团， 产品总监	10:00-10:30 硅基与宽禁带半导体材料共同推动功率半导体技术与产业发展 张波， 电子科技大学， 教授		
	10:30-11:00 电动航空电力系统的挑战和机遇 刘栋良， 卧龙电气驱动集团 股份有限公司， 中央研究院副总裁	10:30-11:00 功率技术发展之路 李国虢， 芯联集成电路制造有限公司， 工业市场营销总监		
	11:00-11:30 航天科技助力低空经济高质量发展 相鑫， 时代飞鹏科技有限公司， 总监	11:00-11:30 RC-IGBT 技术、 产品及应用 陈道坤， 海信功率半导体， 功率器件研发总监		
	11:30-12:00 面向低空经济的电动飞机关键技术与产业变革 皇甫宜耿， 西北工业大学， 教授	11:30-12:00 下一代核心功率器件演进之 SJ IGBT&RugSiC 王畅畅， 苏州华太电子技术股份有限公司， 功率业务市场经理		
	12:00-13:00 午休 固态开关驱动下一代高频高可靠拓扑创新论坛 Solid-State Circuit Breaker Forum	12:00-12:50 会议午餐		
		12:50-13:00 会议抽奖		
	下午	13:00-13:30 [演讲题目待定] 吴翊， 西安交通大学， 教授	13:00-13:30 天科合达大尺寸导电型碳化硅衬底和外延片研究进展 刘春俊， 北京天科合达半导体股份有限公司， 副总经理 技术总监	
		13:30-14:00 固态开关在光储微网中的应用 陈道杰， 上海京硅智能技术有限公司， CMO	13:30-14:00 积塔助力碳化硅功率器件车规应用 吴贤勇， 上海积塔半导体有限公司， 总经理助理 兼七厂厂长	
14:00-14:30 英飞凌 CoolSiC™ 赋能固态配电， 革新系统性能 鲍秀平， 英飞凌科技， 工业与基础设施业务大中国区高级市场经理		14:00-14:30 高性能 SiC MOSFET 技术进展及产业发展趋势 张清纯， 清纯半导体（宁波）有限公司， 董事长		
14:30-15:00 固态式直流断路器关键技术及工程应用 谢文刚， 山东泰开直流技术有限公司， 高级工程师		14:30-15:00 碳化硅功率器件发展趋势及研发进展 刘奥， 扬州国扬电子有限公司， 副总经理		

PCIM Asia Shanghai 2025 同期活动分布



微信扫码关注
“PCIM电力电子新世代”公众号
Follow us on our official
wechat account



扫描二维码
免费报名听会
Scan the QR code to
register for free